|  |
| --- |
| [2023-2029年中国芯片设计行业发展深度调研与未来趋势报告](https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2023-2029年中国芯片设计行业发展深度调研与未来趋势报告](https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html) |
| 报告编号： | 2655065　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：8800 元　　纸介＋电子版：9000 元 |
| 优惠价： | 电子版：7800 元　　纸介＋电子版：8100 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　芯片设计作为信息技术的核心，近年来随着物联网、人工智能等新兴技术的兴起，市场需求持续扩大。当前市场上，芯片设计不仅在性能、功耗方面有了显著提升，还在安全性、可定制性方面实现了突破。随着技术的发展，现代芯片设计不仅能够提供更高效、更低功耗的解决方案，还能通过改进设计提高产品的稳定性和使用便捷性。此外，随着对高性能计算和边缘计算的需求增加，芯片设计也更加注重提供多样化的选择和定制服务。  
　　未来，芯片设计将朝着更高效、更智能、更安全的方向发展。一方面，随着新材料和新技术的应用，芯片设计将采用更先进的制程技术和更高效的电路设计，提高芯片的性能和能效比。另一方面，随着智能技术的应用，芯片设计将集成更多智能化功能，如AI加速器、机器学习算法等，提高芯片的智能化水平。此外，随着网络安全的重要性日益凸显，芯片设计也将更加注重提高数据安全性和隐私保护能力。  
　　《[2023-2029年中国芯片设计行业发展深度调研与未来趋势报告](https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html)》依据国家统计局、发改委及芯片设计相关协会等的数据资料，深入研究了芯片设计行业的现状，包括芯片设计市场需求、市场规模及产业链状况。芯片设计报告分析了芯片设计的价格波动、各细分市场的动态，以及重点企业的经营状况。同时，报告对芯片设计市场前景及发展趋势进行了科学预测，揭示了潜在的市场需求和投资机会，也指出了芯片设计行业内可能的风险。此外，芯片设计报告还探讨了品牌建设和市场集中度等问题，为投资者、企业领导及信贷部门提供了客观、全面的决策支持。  
  
第一章 芯片设计行业相关概述  
　　1.1 芯片的概念和分类  
　　　　1.1.1 芯片基本概念  
　　　　1.1.2 相关概念区分  
　　　　1.1.3 芯片主要分类  
　　1.2 芯片产业链结构  
　　　　1.2.1 芯片产业链结构  
　　　　1.2.2 芯片生产流程图  
　　　　1.2.3 产业链核心环节  
　　1.3 芯片设计行业概述  
　　　　1.3.1 芯片设计行业简介  
　　　　1.3.2 芯片设计基本分类  
　　　　1.3.3 芯片设计产业图谱  
  
第二章 2018-2023年中国芯片设计行业发展环境  
　　2.1 经济环境  
　　　　2.1.1 宏观经济发展概况  
　　　　2.1.2 工业经济运行情况  
　　　　2.1.3 经济转型升级态势  
　　　　2.1.4 未来经济发展展望  
　　2.2 政策环境  
　　　　2.2.1 智能制造发展战略  
　　　　2.2.2 中国制造支持政策  
　　　　2.2.3 集成电路相关政策  
　　　　2.2.4 芯片产业政策汇总  
　　　　2.2.5 产业投资基金支持  
　　2.3 社会环境  
　　　　2.3.1 移动网络运行状况  
　　　　2.3.2 电子信息制造规模  
　　　　2.3.3 研发经费投入增长  
　　　　2.3.4 科技人才队伍壮大  
　　2.4 技术环境  
　　　　2.4.1 芯片领域专利状况  
　　　　2.4.2 芯片技术数量分布  
　　　　2.4.3 芯片技术研发进展  
　　　　2.4.4 芯片技术创新升级  
　　　　2.4.5 芯片技术发展方向  
  
第三章 2018-2023年中国芯片产业发展分析  
　　3.1 2018-2023年中国芯片产业发展综述  
　　　　3.1.1 产业基本特征  
　　　　3.1.2 产业发展背景  
　　　　3.1.3 产业发展意义  
　　　　3.1.4 产业发展进程  
　　　　3.1.5 产业发展提速  
　　3.2 2018-2023年中国芯片市场运行状况  
　　　　3.2.1 产业销售规模  
　　　　3.2.2 市场结构分析  
　　　　3.2.3 产品产量规模  
　　　　3.2.4 企业竞争状况  
　　　　3.2.5 区域发展格局  
　　　　3.2.6 市场应用需求  
　　3.3 2018-2023年中国集成电路进出口数据分析  
　　　　3.3.1 进出口总量数据分析  
　　　　3.3.2 主要贸易国进出口情况分析  
　　　　3.3.3 主要省市进出口情况分析  
　　3.4 2018-2023年中国芯片国产化进程分析  
　　　　3.4.1 芯片国产化发展背景  
　　　　3.4.2 核心芯片的自给率低  
　　　　3.4.3 芯片国产化进展分析  
　　　　3.4.4 芯片国产化存在问题  
　　　　3.4.5 芯片国产化未来展望  
　　3.5 中国芯片产业发展困境分析  
　　　　3.5.1 市场垄断困境  
　　　　3.5.2 过度依赖进口  
　　　　3.5.3 技术短板问题  
　　　　3.5.4 人才短缺问题  
　　3.6 中国芯片产业应对策略分析  
　　　　3.6.1 突破垄断策略  
　　　　3.6.2 化解供给不足  
　　　　3.6.3 加强自主创新  
　　　　3.6.4 加大资源投入  
  
第四章 2018-2023年芯片设计行业发展全面分析  
　　4.1 2018-2023年全球芯片设计行业发展综述  
　　　　4.1.1 市场发展规模  
　　　　4.1.2 市场区域格局  
　　　　4.1.3 市场竞争格局  
　　　　4.1.4 企业排名分析  
　　4.2 2018-2023年中国芯片设计行业运行状况  
　　　　4.2.1 行业发展历程  
　　　　4.2.2 市场发展规模  
　　　　4.2.3 市场竞争格局  
　　　　4.2.4 产品类型分布  
　　　　4.2.5 细分市场发展  
　　4.3 芯片设计企业发展状况分析  
　　　　4.3.1 企业数量规模  
　　　　4.3.2 企业运行状况  
　　　　4.3.3 企业地域分布  
　　　　4.3.4 设计人员规模  
　　4.4 芯片设计行业上市公司财务状况分析  
　　　　4.4.1 上市公司规模  
　　　　4.4.2 上市公司分布  
　　　　4.4.3 经营状况分析  
　　　　4.4.4 盈利能力分析  
　　　　4.4.5 营运能力分析  
　　　　4.4.6 成长能力分析  
　　　　4.4.7 现金流量分析  
　　4.5 芯片设计具体流程剖析  
　　　　4.5.1 规格制定  
　　　　4.5.2 设计细节  
　　　　4.5.3 逻辑设计  
　　　　4.5.4 电路布局  
　　　　4.5.5 光罩制作  
　　4.6 芯片设计行业发展存在的问题和对策  
　　　　4.6.1 行业发展瓶颈  
　　　　4.6.2 行业发展困境  
　　　　4.6.3 产业发展建议  
　　　　4.6.4 产业创新策略  
  
第五章 2018-2023年中国芯片设计行业细分产品发展分析  
　　5.1 逻辑IC产品设计发展状况  
　　　　5.1.1 CPU  
　　　　5.1.2 GPU  
　　　　5.1.3 MCU  
　　　　5.1.4 ASIC  
　　　　5.1.5 FPGA  
　　　　5.1.6 DSP  
　　5.2 存储IC产品设计发展状况  
　　　　5.2.1 DRAM  
　　　　5.2.2 NAND Flash  
　　　　5.2.3 NOR Flash  
　　5.3 模拟IC产品设计发展状况  
　　　　5.3.1 射频器件  
　　　　5.3.2 模数/数模转换器  
　　　　5.3.3 电源管理产品  
  
第六章 中国芯片设计工具——EDA（电子设计自动化）软件市场发展状况  
　　6.1 EDA软件基本概述  
　　　　6.1.1 EDA软件基本概念  
　　　　6.1.2 EDA软件的重要性  
　　　　6.1.3 EDA软件主要类型  
　　　　6.1.4 EDA软件设计过程  
　　　　6.1.5 EDA软件设计步骤  
　　6.2 中国芯片设计EDA软件行业发展分析  
　　　　6.2.1 行业发展规模  
　　　　6.2.2 市场竞争状况  
　　　　6.2.3 国产EDA机遇  
　　　　6.2.4 行业发展瓶颈  
　　　　6.2.5 行业发展对策  
　　6.3 集成电路EDA行业竞争状况  
　　　　6.3.1 市场竞争格局  
　　　　6.3.2 国际EDA企业  
　　　　6.3.3 国内EDA企业  
　　6.4 EDA技术及工具发展沿革及作用  
　　　　6.4.1 GDS&GDS II  
　　　　6.4.2 SPICE  
　　　　6.4.3 半导体器件模型（SPICE Model）  
　　　　6.4.5 静态时序分析  
  
第七章 中国芯片设计产业园区建设分析  
　　7.1 深圳集成电路设计应用产业园  
　　　　7.1.1 园区发展环境  
　　　　7.1.2 园区基本简介  
　　　　7.1.3 园区战略定位  
　　　　7.1.4 园区服务内容  
　　7.2 北京中关村集成电路设计园  
　　　　7.2.1 园区发展环境  
　　　　7.2.2 园区基本简介  
　　　　7.2.3 园区战略定位  
　　　　7.2.4 园区发展状况  
　　　　7.2.5 园区企业合作  
　　　　7.2.6 园区发展规划  
　　7.3 上海集成电路设计产业园  
　　　　7.3.1 园区发展环境  
　　　　7.3.2 园区基本简介  
　　　　7.3.3 园区入驻企业  
　　　　7.3.4 园区项目建设  
　　　　7.3.5 园区发展规划  
　　7.4 无锡国家集成电路设计产业园  
　　　　7.4.1 园区发展环境  
　　　　7.4.2 园区基本简介  
　　　　7.4.3 园区发展状况  
　　　　7.4.4 园区区位优势  
　　7.5 杭州集成电路设计产业园  
　　　　7.5.1 园区发展环境  
　　　　7.5.2 园区基本简介  
　　　　7.5.3 园区签约项目  
　　　　7.5.4 园区发展规划  
  
第八章 2018-2023年国外芯片设计重点企业经营状况  
　　8.1 博通（Broadcom）  
　　　　8.1.1 企业发展概况  
　　　　8.1.2 企业经营状况  
　　　　8.1.3 企业并购动态  
　　　　8.1.4 产品研发动态  
　　8.2 高通（Qualcomm）  
　　　　8.2.1 企业发展概况  
　　　　8.2.2 企业经营状况  
　　　　8.2.3 企业布局分析  
　　　　8.2.4 企业发展战略  
　　8.3 英伟达（NVIDIA）  
　　　　8.3.1 企业发展概况  
　　　　8.3.2 企业经营状况  
　　　　8.3.3 企业竞争优势  
　　　　8.3.4 企业发展前景  
　　8.4 超微（AMD）  
　　　　8.4.1 企业发展概况  
　　　　8.4.2 企业经营状况  
　　　　8.4.3 产品研发动态  
　　　　8.4.4 企业战略合作  
　　8.5 赛灵思（Xilinx）  
　　　　8.5.1 企业发展概况  
　　　　8.5.2 企业经营状况  
　　　　8.5.3 产品研发动态  
　　　　8.5.4 企业发展战略  
  
第九章 2018-2023年国内芯片设计重点企业经营状况  
　　9.1 联发科  
　　　　9.1.1 企业发展概况  
　　　　9.1.2 企业经营状况  
　　　　9.1.3 产品研发动态  
　　　　9.1.4 企业布局战略  
　　9.2 华为海思  
　　　　9.2.1 企业发展概况  
　　　　9.2.2 企业经营状况  
　　　　9.2.3 企业发展成就  
　　　　9.2.4 业务布局动态  
　　　　9.2.5 企业业务计划  
　　　　9.2.6 企业发展动态  
　　9.3 紫光展锐  
　　　　9.3.1 企业发展概况  
　　　　9.3.2 企业经营状况  
　　　　9.3.3 企业芯片平台  
　　　　9.3.4 企业研发项目  
　　　　9.3.5 企业合作发展  
　　9.4 中兴微电子  
　　　　9.4.1 企业发展概况  
　　　　9.4.2 企业经营状况  
　　　　9.4.3 企业技术进展  
　　　　9.4.4 企业发展前景  
　　9.5 华大半导体  
　　　　9.5.1 企业发展概况  
　　　　9.5.2 企业发展状况  
　　　　9.5.3 企业布局分析  
　　　　9.5.4 企业发展动态  
　　9.6 汇顶科技  
　　　　9.6.1 企业发展概况  
　　　　9.6.2 经营效益分析  
　　　　9.6.3 业务经营分析  
　　　　9.6.4 财务状况分析  
　　　　9.6.5 核心竞争力分析  
　　　　9.6.6 公司发展战略  
　　　　9.6.7 未来前景展望  
　　9.7 兆易创新  
　　　　9.7.1 企业发展概况  
　　　　9.7.2 经营效益分析  
　　　　9.7.3 业务经营分析  
　　　　9.7.4 财务状况分析  
　　　　9.7.5 产品研发动态  
　　　　9.7.6 核心竞争力分析  
　　　　9.7.7 公司发展战略  
　　　　9.7.8 未来前景展望  
  
第十章 对芯片设计行业投资价值综合分析  
　　10.1 对集成电路产业投资价值评估及投资建议  
　　　　10.1.1 投资价值综合评估  
　　　　10.1.2 市场机会矩阵分析  
　　　　10.1.3 产业进入时机分析  
　　　　10.1.4 产业投资风险剖析  
　　　　10.1.5 产业投资策略建议  
　　10.2 对芯片设计行业进入壁垒评估  
　　　　10.2.1 行业竞争壁垒  
　　　　10.2.2 行业技术壁垒  
　　　　10.2.3 行业资金壁垒  
　　10.3 对芯片设计行业投资状况分析  
　　　　10.3.1 产业投资规模  
　　　　10.3.2 产业投资热点  
　　　　10.3.3 基金投资策略  
　　　　10.3.4 投资项目分析  
  
第十一章 中.智.林.－对2023-2029年芯片设计行业发展趋势和前景预测分析  
　　11.1 中国芯片市场发展机遇分析  
　　　　11.1.1 产业发展机遇分析  
　　　　11.1.2 市场变动带来机遇  
　　　　11.1.3 产业未来发展趋势  
　　11.2 中国芯片设计行业发展前景展望  
　　　　11.2.1 技术创新发展  
　　　　11.2.2 市场需求状况  
　　　　11.2.3 行业发展前景  
　　11.3 对2023-2029年中国芯片设计行业预测分析  
　　　　11.3.1 2023-2029年中国芯片设计行业影响因素分析  
　　　　11.3.2 2023-2029年中国芯片设计行业销售规模预测  
  
图表目录  
　　图表 1 芯片产品分类  
　　图表 2 集成电路产业链及部分企业  
　　图表 3 芯片生产历程  
　　图表 4 芯片设计产业图谱  
　　图表 5 2018-2023年国内生产总值及其增长速度  
　　图表 6 2018-2023年三次产业增加值占国内生产总值比重  
　　图表 7 2023年中国GDP核算数据  
　　图表 8 2023年规模以上工业增加至同比增长速度  
　　图表 9 2023年规模以上工业生产主要数据  
　　图表 10 2022-2023年规模以上工业增加值同比增长速度  
　　图表 11 2023年规模以上工业生产主要数据  
　　图表 12 智能制造系统架构  
　　图表 13 智能制造系统层级  
　　图表 14 MES制造执行与反馈流程  
　　图表 15 《中国制造2025》半导体产业政策目标与政策支持  
　　图表 16 2023-2029年IC产业政策目标与发展重点  
　　图表 17 国家支持集成电路产业发展的部分重点政策  
　　图表 18 中国芯片产业相关政策汇总（一）  
　　图表 19 中国芯片产业相关政策汇总（二）  
　　图表 20 一期大基金投资各领域份额占比  
　　图表 21 2018-2023年中国网民规模和互联网普及率  
　　图表 22 2018-2023年手机网民规模及其占网民比例  
　　图表 23 2022-2023年电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速  
　　图表 24 2022-2023年电子信息制造业主营业务收入、利润增速变动情况  
　　图表 25 2022-2023年电子信息制造业PPI分月增速  
　　图表 26 2022-2023年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况  
　　图表 27 2022-2023年通信设备行业增加值和出口交货值分月增速  
　　图表 28 2022-2023年电子元件行业增加值和出口交货值分月增速  
　　图表 29 2022-2023年电子器件行业增加值和出口交货值分月增速  
　　图表 30 2022-2023年计算机制造业增加值和出口交货值分月增速  
　　图表 31 2018-2023年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度  
　　图表 32 2023年专利申请、授权和有效专利情况  
　　图表 33 英特尔晶圆制程技术路线  
　　图表 34 芯片封装技术发展路径  
　　图表 35 2018-2023年中国集成电路产业销售额及增速  
　　图表 36 2018-2023年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况  
　　图表 37 2018-2023年中国集成电路产量趋势图  
　　图表 38 2023年全国集成电路产量数据  
　　图表 39 2023年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况  
　　图表 40 2023年全国集成电路产量数据  
　　图表 41 2023年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况  
　　图表 42 2023年全国集成电路产量数据  
　　图表 43 2023年主要省份集成电路产量占全国产量比重情况  
　　图表 44 2023年集成电路产量集中程度示意图  
　　图表 45 2023年全球芯片产品下游应用情况  
　　图表 46 2018-2023年中国集成电路进出口总额  
　　图表 47 2018-2023年中国集成电路进出口结构  
　　图表 48 2018-2023年中国集成电路贸易逆差规模  
　　图表 49 2022-2023年中国集成电路进口区域分布  
　　图表 50 2022-2023年中国集成电路进口市场集中度（分国家）  
　　图表 51 2023年主要贸易国集成电路进口市场情况  
　　……  
　　图表 53 2022-2023年中国集成电路出口区域分布  
　　图表 54 2022-2023年中国集成电路出口市场集中度（分国家）  
　　图表 55 2023年主要贸易国集成电路出口市场情况  
　　……  
　　图表 57 2022-2023年主要省市集成电路进口市场集中度（分省市）  
　　图表 58 2023年主要省市集成电路进口情况  
　　……  
　　图表 60 2022-2023年中国集成电路出口市场集中度（分省市）  
　　图表 61 2023年主要省市集成电路出口情况  
　　……  
　　图表 63 核心芯片占有率状况  
　　图表 64 有代表性的国产芯片厂商及其业界地位  
　　图表 65 国内主要存储芯片项目及其进展  
　　图表 66 芯片行业部分国际公司在内地的布局情况  
　　图表 67 2018-2023年全球IC设计业销售额  
　　图表 68 2023年全球集成电路设计市场销售额占比分布  
　　图表 69 2022-2023年全球前十大IC设计公司排名  
　　图表 70 IC设计的不同阶段  
　　图表 71 2018-2023年中国IC设计行业销售额及增长率  
　　图表 72 2023年中国十大芯片设计企业  
　　图表 73 2018-2023年营收过亿企业数量统计  
　　图表 74 2022-2023年芯片设计营收过亿元企业城市分布  
　　图表 75 2023年各营收区间段企业数量分布  
　　图表 76 2022-2023年中国大陆各区域IC设计营收分析  
　　图表 77 2023年各区域销售额及占比分析  
　　图表 78 2022-2023年大IC设计城市增速比较  
　　图表 79 2022-2023年IC设计行业营收排名前十的城市  
　　图表 80 IC设计行业上市公司名单（前20家）  
　　图表 81 2018-2023年IC设计行业上市公司资产规模及结构  
　　图表 82 IC设计行业上市公司上市板分布情况  
　　图表 83 IC设计行业上市公司地域分布情况  
　　图表 84 2018-2023年IC设计行业上市公司营业收入及增长率  
　　图表 85 2018-2023年IC设计行业上市公司净利润及增长率  
　　图表 86 2018-2023年IC设计行业上市公司毛利率与净利率  
　　图表 87 2018-2023年IC设计行业上市公司营运能力指标  
　　图表 88 2022-2023年IC设计行业上市公司营运能力指标  
　　图表 89 2018-2023年IC设计行业上市公司成长能力指标  
　　图表 90 2022-2023年IC设计行业上市公司成长能力指标  
　　图表 91 2018-2023年IC设计行业上市公司销售商品收到的现金占比  
　　图表 92 芯片设计流程图  
　　图表 93 芯片设计流程  
　　图表 94 32bits加法器的Verilog范例  
　　图表 95 光罩制作示意图  
　　图表 96 2018-2023年全球逻辑IC销量及增速  
　　图表 97 全球大型逻辑IC公司分类  
　　图表 98 CPU  
　　图表 99 CPU微架构示意图  
　　图表 100 主要CPU公司介绍  
　　图表 101 2018-2023年Intel及AMD全球营业收入  
　　图表 102 2018-2023年桌面CPU公司净利率变化  
　　图表 103 PC处理器市场份额  
　　图表 104 CPU主要应用领域  
　　图表 105 主要移动CPU公司介绍  
　　图表 106 2018-2023年移动CPU领域各公司营收情况  
　　图表 107 2018-2023年移动CPU公司净利率变化  
　　图表 108 全球移动CPU市场份额  
　　图表 109 2023年各大科技巨头获得专利数量  
　　图表 110 高通主要移动CPU平台  
　　图表 111 GPU可以解决的问题  
　　图表 112 GPU的重要应用领域  
　　图表 113 GPU  
　　图表 114 GPU微架构示意图  
　　图表 115 NVIDIA及AMD公司营收  
　　图表 116 独立显卡市场份额  
　　图表 117 两大GPU公司净利率变化  
　　图表 118 2023-2029年中国GPU服务器市场规模预测  
　　图表 119 2023年中国GPU服务器厂商市场份额  
　　图表 120 2023-2029年MCU市场规模预测  
　　图表 121 比特大陆蚂蚁矿机S15  
　　图表 122 ASIC矿机芯片  
　　图表 123 FPGA  
　　图表 124 FPGA内部结构图  
　　图表 125 FPGA可小批量替代ASIC的原因  
　　图表 126 计算密集型任务时CPU、GPU、FPGA、ASIC的数量级比较  
　　图表 127 芯片开发成本随工艺制程大幅提升  
　　图表 128 FPGA主要公司介绍  
　　图表 129 2018-2023年主要FPGA公司全球营业收入  
　　图表 130 全球四大FPGA厂商市占率  
　　图表 131 2018-2023年全球FPGA主要厂商净利率变化  
　　图表 132 Xilinx FPGA重点应用领域  
　　图表 133 DSP  
　　图表 134 DSP内部结构图  
　　图表 135 DSP重要应用领域  
　　图表 136 DSP主要公司介绍  
　　图表 137 2018-2023年全球主要DSP公司营收  
　　图表 138 2018-2023年DSP厂商净利率变化  
　　图表 139 多种计算类芯片的对比  
　　图表 140 存储器的分类  
　　图表 141 主要存储器产品  
　　图表 142 2018-2023年全球存储器销售额情况  
　　图表 143 2023年世界半导体产品结构及增速  
　　图表 144 SRAM内部结构图  
　　图表 145 DRAM内部结构图  
　　图表 146 SRAM、DRAM、SDRAM、DDR3、DDR4参数对比  
　　图表 147 DRAM传输速度跟随CPU性能提升不断提高  
　　图表 148 主要DRAM存储器公司  
　　图表 149 2023年全球DRAM厂商自有品牌内存营收  
　　图表 150 DRAM价格走势变化  
　　图表 151 DRAM三大厂商净利率变化  
　　图表 152 2023年全球DRAM厂自有品牌内存市占率  
　　图表 153 DRAM裸片容量发展进度  
　　图表 154 全球三大存储器公司DRAM工艺制程持续领跑全球  
　　图表 155 Flash的内部存储结构  
　　图表 156 NAND Flash架构图  
　　图表 157 闪存芯片存储原理  
　　图表 158 SLC、MLC、TLC的电荷变化  
　　图表 159 SLC、MLC、TLC性能对比  
　　图表 160 2D NAND通过3D芯片堆叠技术实现3D NAND以大幅提升存储容量  
　　图表 161 主要NAND FLASH公司  
　　图表 162 2018-2023年全球主要存储器厂商营收  
　　图表 163 主要NAND FLASH品种价格变化趋势  
　　图表 164 2018-2023年NAND FLASH主流厂商利润率变化  
　　图表 165 全球主流存储器公司NAND工艺制程表  
　　图表 166 NAND FLASH主要应用领域  
　　图表 167 NAND FLASH与NOR FLASH对比  
　　图表 168 2018-2023年全球模拟芯片应用领域份额  
　　图表 169 2018-2023年全球模拟IC销售额  
　　图表 170 2023年全球前十大模拟厂商营收情况  
　　图表 171 模拟芯片产业特点  
　　图表 172 射频前端结构示意图  
　　图表 173 数模转换器结构示意图  
　　图表 174 2018-2023年全球EDA行业市场规模  
　　图表 175 2023年全球EDA行业分产品市场规模占比  
　　图表 176 2023年全球EDA行业市场结构  
　　图表 177 中国主要EDA企业产品与服务领域  
　　图表 178 中国本土EDA企业发展建议  
　　图表 179 2022-2023年博通有限公司综合收益表  
　　图表 180 2022-2023年博通有限公司分部资料  
　　图表 181 2022-2023年博通有限公司收入分地区资料  
　　图表 182 2022-2023年博通有限公司综合收益表  
　　图表 183 2022-2023年博通有限公司分部资料  
　　图表 184 2022-2023年博通有限公司收入分地区资料  
　　图表 185 2022-2023年博通有限公司综合收益表  
　　图表 186 2022-2023年博通有限公司分部资料  
　　图表 187 2022-2023年高通综合收益表  
　　图表 188 2022-2023年高通收入分地区资料  
　　图表 189 2022-2023年高通综合收益表  
　　图表 190 2022-2023年高通收入分地区资料  
　　图表 191 2022-2023年高通综合收益表  
　　图表 192 2022-2023年英伟达综合收益表  
　　图表 193 2022-2023年英伟达分部资料  
　　图表 194 2022-2023年英伟达收入分地区资料  
　　图表 195 2022-2023年英伟达综合收益表  
　　图表 196 2022-2023年英伟达分部资料  
　　图表 197 2022-2023年英伟达收入分地区资料  
　　图表 198 2022-2023年英伟达综合收益表  
　　图表 199 2022-2023年英伟达分部资料  
　　图表 200 2022-2023年英伟达收入分地区资料  
　　图表 201 2022-2023年美国超微公司综合收益表  
　　图表 202 2022-2023年美国超微公司分部资料  
　　图表 203 2022-2023年美国超微公司收入分地区资料  
　　图表 204 2022-2023年美国超微公司综合收益表  
　　图表 205 2022-2023年美国超微公司分部资料  
　　图表 206 2022-2023年美国超微公司收入分地区资料  
　　图表 207 2022-2023年美国超微公司综合收益表  
　　图表 208 2022-2023年美国超微公司分部资料  
　　图表 209 2022-2023年赛灵思公司综合收益表  
　　图表 210 2022-2023年赛灵思公司收入分地区资料  
　　图表 211 2022-2023年赛灵思公司综合收益表  
　　图表 212 2022-2023年赛灵思公司收入分地区资料  
　　图表 213 2022-2023年赛灵思公司综合收益表  
　　图表 214 2022-2023年赛灵思公司收入分地区资料  
　　图表 215 2022-2023年联发科综合收益表  
　　图表 216 2022-2023年联发科收入分地区资料  
　　图表 217 2022-2023年联发科综合收益表  
　　图表 218 2022-2023年联发科收入分地区资料  
　　图表 219 2022-2023年联发科综合收益表  
　　图表 220 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司总资产及净资产规模  
　　图表 221 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司营业收入及增速  
　　图表 222 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司净利润及增速  
　　图表 223 2023年深圳市汇顶科技股份有限公司主营业务分行业、产品、地区  
　　图表 224 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司营业利润及营业利润率  
　　图表 225 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司净资产收益率  
　　图表 226 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司短期偿债能力指标  
　　图表 227 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司资产负债率水平  
　　图表 228 2018-2023年深圳市汇顶科技股份有限公司运营能力指标  
　　图表 229 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司总资产及净资产规模  
　　图表 230 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司营业收入及增速  
　　图表 231 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司净利润及增速  
　　图表 232 2023年北京兆易创新科技股份有限公司主营业务分行业、产品、地区  
　　图表 233 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司营业利润及营业利润率  
　　图表 234 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司净资产收益率  
　　图表 235 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司短期偿债能力指标  
　　图表 236 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司资产负债率水平  
　　图表 237 2018-2023年北京兆易创新科技股份有限公司运营能力指标  
　　图表 238 集成电路产业投资价值四维度评估表  
　　图表 239 集成电路产业市场机会整体评估表  
　　图表 247 2023年IC业各大厂商大陆建厂计划  
　　图表 248 对2023-2029年中国芯片设计行业销售规模预测  
略……

了解《[2023-2029年中国芯片设计行业发展深度调研与未来趋势报告](https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html)》，报告编号：2655065，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：[Kf@20087.com](mailto:Kf@20087.com)

详细介绍：<https://www.20087.com/5/06/XinPianSheJiHangYeQuShiFenXi.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！